

股票简称:韦尔股份 股票代码:603501 公告编号:2021-012

# 上海韦尔半导体股份有限公司

Shanghai Will Semiconductor CO.,Ltd.

(注册地址:中国(上海)自由贸易试验区龙东大道3000号1幢C楼7层)

## 公开发行可转换公司债券上市公告书

### 保荐机构(主承销商)

(深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层)  
二〇二一年一月

#### 第一节 重要声明与提示

上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称“韦尔股份”、“发行人”、“公司”或“本公司”)全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公司不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、上海证券交易所(以下简称“上交所”)、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见,均不表明对本公司任何保证。

本公司提醒广大投资者注意,凡上市公司公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅2020年12月24日刊载于《中国证券报》和《证券时报》的《上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于上交所指定网站(<http://www.sse.com.cn>)的《上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)全文。

如无特别说明,上市公司公告书使用的简称或名称同《募集说明书》相同。

#### 第二节 概览

- 一、可转换公司债券简称:韦尔转债
- 二、可转换公司债券代码:113616
- 三、可转换公司债券发行量:244,000万元(2,440万张)
- 四、可转换公司债券上市量:244,000万元(2,440万张)
- 五、可转换公司债券上市地:上海证券交易所
- 六、可转换公司债券上市时间:2021年1月22日
- 七、可转换公司债券存兑期限的起止日期:2020年12月28日至2026年12月27日。
- 八、可转换公司债券转股期的起止日期:2021年7月5日至2026年12月27日。
- 九、可转换公司债券付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日(即2020年12月28日)起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
- 十、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
- 十一、保荐机构(主承销商):平安证券股份有限公司
- 十二、可转换公司债券的担保情况:本次发行的可转换公司债券未提供担保。
- 十三、可转换公司债券信用评级及资信评级机构:公司的主体信用等级为“AA+”,本次可转债的信用等级为“AA+”,评级展望为“稳定”,评级机构为上海新世纪。

#### 第三节 绪言

本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。

经中国证监会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]3024号)核准,公司于2020年12月28日公开发行2,440万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额244.0亿元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行入原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行(以下简称“网上发行”)。本次发行认购金额不足24.40亿元的部分由保荐机构(主承销商)包销。

经上海证券交易所“自律监管决定书[2021]24号”同意,公司24.40亿元可转换公司债券将于2021年1月22日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“韦尔转债”,债券代码“113616”。

本公司已于2020年12月24日在《中国证券报》和《证券时报》刊登了《上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》。《募集说明书》全文可以在上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)查询。

#### 第四节 发行人概况

一、发行人基本情况	
中文名称	上海韦尔半导体股份有限公司
英文名称	Shanghai Will Semiconductor CO., Ltd.
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区龙东大道3000号1幢C楼7层
上市地点	上海证券交易所
股票简称	韦尔股份
注册资本	983,576,568元
股票代码	603501/2816
成立日期	2007年8月14日
上市时间	2017年6月14日
经营范围	集成电路、计算机软硬件的设计、开发、销售、商务信息咨询、从事货物及技术的进出口业务,自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
法定代表人	王煜
董事会秘书	贾鹏
证券事务代表	任冰
联系电话	021-50805043
传真	021-50152960
邮政编码	201210
互联网网址	<a href="http://www.willsemi.com">www.willsemi.com</a>
电子信箱	<a href="mailto:will_stock@corp.vot.com">will_stock@corp.vot.com</a>

#### 二、发行人首次公开发行及上市后股本变动情况

(一)2017年首次公开发行股票并上市

经中国证监会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司首次公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]469号)核准,公司于2017年6月14日在上海证券交易所首次公开发行4,160万股A股股票,发行价格为每股人民币0.2元。2017年公司首次公开发行股票并上市后,总股本为941,600万股。

(二)2019年发行股份购买资产并募集配套资金

经中国证监会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司向绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2019]1001号)核准,公司向绍兴市韦豪等26名北京豪威股份发行386,442,308股A股股票,向北京博融利和科技股份有限公司等8名惠科股份发行6,962,394股A股股票,向陈东等9名信德股份发行7,566,745股A股股票,发行价格为每股人民币33.70元。

同时,公司向富国基金管理有限公司、国元国际控股有限公司、博时基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司和南方基金管理股份有限公司共计五名特定投资者非公开发行77,006,711股A股股票,发行价格为每股人民币75.68元。

2019年,公司发行股份购买资产以及配套募集资金完成后,总股本为983,662,098股。

#### 三、发行人的主要业务情况

##### (一)主要业务和主要产品

公司主要从事半导体产品设计与分销业务,主要产品包括CMOS图像传感器、触控与显示驱动集成电路、分立器件(TVS、MOSFET、肖特基二极管等)、电源管理IC(Charger、DC-DC、LED背光驱动等)、射频器件及IC、MEMS麦克风传感器等半导体产品,同时从事被动器件(包括电阻、电容、电感等)、结构器件、分立器件和中等半导体产品的分销业务。公司的半导体分立器件和电源管理产品在细分市场具有较强的竞争力,公司产品豪威科技是全球前三大CMOS图像传感器供应商之一。

2019年,公司半导体设计业务收入占比主营业务收入的比例为83.56%,公司CMOS图像传感器收入占主营业务收入的占比达71.94%,CMOS图像传感器产品型号覆盖了8万种像素至6,400万像素各种规格,具备丰富的产品体系。针对不同应用领域的各类应用,公司可根据不同设备的尺寸大小、光敏度、封装类型以及芯片内嵌式图像信号处理等方面的区别,提供定制化产品解决方案。2020年1-9月,公司半导体设计业务收入占主营业务收入的比例为72.1%。2020年,公司收购了Synaptics Incorporated于亚洲地区的单芯片液晶模组与显示驱动集成电路芯片业务,产品研发能力进一步提升。公司为全球知名的提供先进数字成像解决方案的芯片设计公司,产品已经广泛应用于消费电子和工业应用领域,包括智能手机、平板电脑、笔记本电脑、网络摄像头、安全监控系统、数码相机、汽车和医疗设备等。

同时,公司作为国内主要半导体产品分销之一,凭借着成熟的技术支持团队和完善的供应链管理体系统,与全球主要半导体供应商、国内各大模组厂商以及终端客户长期保持着良好的合作关系。

##### (二)发行人的竞争优势

1.半导体设计及销售业务在行业中的竞争地位

公司是全球少数具备丰富产品线及强大设计能力的半导体设计公司,产品包括图像传感器和其他半导体器件。公司图像传感器产品包括CMOS图像传感器芯片、硅基液晶显示芯片(LCOS)、微型影像模组封装(Camera Cube Chip),特定用途集成电路产品(ASIC),其中CMOS图像传感器芯片产品型号覆盖了8万种像素至6,400万像素各种规格。公司其他半导体器件产品主要包括分立器件(TVS、MOSFET、肖特基二极管)、电源管理IC(Charger、DC-DC、LED背光驱动等)、射频器件及IC、卫星通信器件、MEMS麦克风传感器等。

近几年,全球CMOS图像传感器市场迎来新的增长高峰,与此同时CMOS图像传感器主要厂商之间的竞争也在升温,市场份额向头部企业集中,并已经呈现寡头竞争格局。全球前三大CMOS图像传感器供应商市场份额变化情况如下:

2014年		2019年	
日本索尼	27%	日本索尼	49%
韩国三星	19%	韩国三星	18%
豪威科技	17%	豪威科技	10%
合计	62%	合计	77%

数据来源:Yole Development、RITechno Systems Research(TSR)

日本索尼、韩国三星、豪威科技是CMOS图像传感器行业主要厂商,2014年至2019年,前三大厂商的市场份额从63%升至77%,形成了寡头竞争格局。

索尼是日本的一家全球知名的大型综合性跨国企业集团,是世界领先、电子游戏、通讯产品和信息技术等领域领先企业之一。在CMOS图像传感器领域,索尼是市场占有率最高的厂商。索尼公司在2012年推出堆栈式(Stacked)CMOS技术,可使传感器在相同尺寸规格下得到更多的感光面积获得更大面积的感光范围。长期以来,索尼在高端CMOS图像传感器市场保持较为显著的技术优势。

三星是韩国最大的跨国企业集团,包括众多的下属企业,业务涉及电子、金融、机械、化学等众多领域。同时三星也是CMOS图像传感器行业主要供应商及生产企业之一,借助三星自身品牌智能手机、平板电脑和其他消费电子设备的市场知名度和占有率,在CMOS图像传感器市场,三星是豪威科技的主要竞争对手之一。

从经营模式来看,豪威科技属于Fabless厂商,生产环节主要委托业内知名晶圆代工企业,日本索尼和韩国三星均属于IDM厂商,拥有晶圆工厂。现阶段,三家厂商在CMOS图像传感器技术积累、技术研发和产品生产三个方面的优势如下:

公司名称	技术积累	技术研发	产品生产	综合
豪威科技	★★★★	★★★★	★★★★	7
日本索尼	★★★★	★★★★	★★★★	8
韩国三星	★★★★	★★★★	★★★★	9

技术积累:上述三大厂商中,豪威科技是最早专注于CMOS图像传感器的设计和研发,拥有较为全面的技术积累和丰富的研发经验。豪威科技技术不仅局限于高像素产品开发,对于CMOS图像传感器在其他领域的应用也有深厚的技术积累。由于智能手机与安防、汽车在技术应用上存在一定的差异,如手机追求影像拍摄影清晰、连贯,而汽车安防则追求光线瞬间变化对图像的影响以及图像传感器持续工作的稳定性,因而在技术路线上也存在一定的差异。因此豪威科技的技术积累较索尼及三星等专注于消费类电子的CMOS图像传感器厂商更有技术优势。例如,豪威于2008年首先推出运用ISXTech CMOS图像传感器已经成为CMOS图像传感器最主流的技术团队。

技术研发:日本索尼拥有经验丰富的研发团队,关键技术的开发速度和新产品选代速度均处于行业领先地位。公司于2019年完成对豪威科技的收购,在扩招研发团队的同时,对1,107名公司研发及核心人员授予了股票期权,大大提高了研发团队稳定性,为公司技术的拓展奠定了人才基础。

产品生产:日本索尼和韩国三星均为IDM企业,生产能力强于豪威科技。由于晶圆厂的投资巨大,通常IDM公司对晶圆厂不会轻易地进行投入建厂,但是随着CMOS图像传感器逐渐向高端、高制程逐渐升级,豪威通过Fabless模式向台积电等拥有国际先进制程的晶圆厂代工,于2020年4月推出了OV646,是世界首颗7纳米、6400万像素的图像传感器,在工艺制程上已经超过了三星的工艺制程。

根据中国产业网代理及销售业务在行业中的竞争地位

排名	公司名称	总营收
1	中电通	191.00
2	泰科源	186.30
3	深圳华强	143.55
4	顺时电子	142.00
5	韦尔股份	136.32
6	力源信息	131.32
7	英唐智控	119.50
8	芯和芯数码	111.60
9	豪威实业	90.00
10	海康集团	72.00

数据来源:国际电子商情

注:韦尔股份136.32亿元包含半导体设计收入,实际销售收入为22.35亿元。

而从国际上来看,Analog、Avnet(安费利)、WPGHolding(世界集团)等世界知名半导体分销商收入均超200亿美元,在行业内均有规模、稳定的客户资源,具备稳定、高效的营销模式,形成差异化的竞争优势。长期以来,公司通过不断提升产品品质和开拓市场,构建了稳定、高效的营销模式,形成差异化的竞争优势,并不断丰富代理的产品线类型,新客户开发数量取得有效突破。半导体分销业务是公司了解市场需求的直接信息来源,在保持现有的半导体分销业务销售规模的前提下,公司更多地将通过代理产品类型、丰富客户群及产品应用领域的方式,助力公司半导体设计业务迅速发展。

#### 四、发行人股本结构及前十名股东持股情况

##### (一)发行人股本结构

截至2020年9月30日,发行人股本结构如下:

持有人类别	无限售条件流通股		限售条件流通股/非流通股		总计	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
境内自然人	363,610,922	42.11	19,804,470	2.29	383,415,392	44.40
境外自然人	—	—	—	—	—	—
国有法人	1,308,217	0.15	—	—	1,308,217	0.15
境外法人	—	—	—	—	—	—
境外法人(含QFLP、QDLP)	19,360,568	2.24	—	—	19,360,568	2.24
其他	378,653,412	43.85	80,839,009	9.36	459,492,421	53.21
合计	762,933,119	88.35	100,643,479	11.65	863,576,598	100.00

数据来源:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

##### (二)发行人前十名大股东持股情况如下:

序号	股东名称	股东性质	持股数量(股)	持股比例(%)	股份限售数量(股)
1	虞仁荣	境内自然人	279,435,000	32.36	0
2	绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	80,839,009	9.36	80,839,009
3	青岛融通民和投资有限公司(有限合伙)	境内非国有法人	57,126,773	6.62	0
4	Shanghai Strategic Investments (A3), LLC	境外法人	30,397,891	3.52	0
5	香港中央结算有限公司	境外法人	28,654,760	3.32	0
6	嘉兴华清华信泰顺股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	26,814,084	3.11	0
7	嘉兴华清龙文泰顺股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	26,814,084	3.11	0
8	上海富友企业管理有限公司(有限合伙)	境内非国有法人	17,846,913	2.07	0
9	Shanghai Investments, LLC	境外法人	16,397,590	1.90	0
10	元来瑞康(苏州)投资管理有限公司-合肥元来瑞康股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	16,185,756	1.87	0
	合计		580,510,880	67.24	80,839,009

#### 第五节 发行与承销

##### 一、本次发行情况

- 1.发行数量:244,000万元(244万手)
- 2.向原A股股东发行的数量:向原无限售条件股东优先配售的韦尔转债总计为229,025手,占本次发行总额的99.39%;向原无限售条件股东优先配售的韦尔转债总计为1,585,459手,占本次发行总额的64.98%;合计向原A股股东优先配售韦尔转债1,814,484手,占本次发行总额的74.36%。
- 3.发行价格:按票面金额平价发行。
- 4.可转换公司债券的面值:人民币100元/张。
- 5.募集资金总额:人民币244,000万元。
- 6.发行方式:本次发行向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式进行,认购金额不足24.40亿元的部分由保荐机构(主承销商)包销。
- 7.配发及发行结果:向原无限售条件股东优先配售的韦尔转债总计为229,025手,占本次发行总额的99.39%;向原无限售条件股东优先配售的韦尔转债总计为1,585,459手,占本次发行总额的64.98%;网上向社会公众投资者发行的韦尔转债总计为613,741手,占本次发行总额的25.15%;主承销商包销本次可转换公司债券的数量为11,776手,占本次发行总额的0.48%。
- 8.前十名可转换公司债券持有人及其持有量

序号	持有人名称	持有数量(元)	持有转债比例(%)
1	虞仁荣	785,771,000	32.20
2	绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业(有限合伙)	227,319,000	9.32
3	青岛融通民和投资有限公司(有限合伙)	123,760,000	5.07
4	嘉兴华清华信泰顺股权投资合伙企业(有限合伙)	62,939,000	2.58
5	嘉兴华清龙文泰顺股权投资合伙企业(有限合伙)	62,894,000	2.58
6	发行股份购买资产-国信新成或弘毅型证券投资基金	20,796,000	0.85
7	中国银行股份有限公司-国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	16,802,000	0.69
8	马剑秋	16,727,000	0.69
9	国信	16,282,000	0.67
10	中国建设银行股份有限公司-华夏国建半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	15,886,700	0.63

##### 9.发行费用总额及项目

项目	金额(万元,不含增值税)
承销及保荐费用	4,426.42
律师费用	230.00
会计师事务所费用	224.53
审计师费用	23.58
用于本次发行的信息披露及其他发行费用	80.29
合计	4,984.81

##### 本次承销情况

本次可转换公司债券发行总额为244,000万元(244万手),向原无限售条件股东优先配售的韦尔转债总计为229,025手,占本次发行总额的99.39%;向原无限售条件股东优先配售的韦尔转债总计为1,585,459手,占本次发行总额的64.98%;网上向社会公众投资者发行的韦尔转债总计为613,741手,占本次发行总额的25.15%;主承销商包销本次可转换公司债券的数量为11,776手,占本次发行总额的0.48%。

##### 三、本次发行资金情况

本次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐承销费用后的余额已由主承销商于2021年1月4日汇入公司指定的募集资金专项存储账户,立信会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资并出具了《验资报告》(信会师报字[2021]第ZA10003号)。

#### 第六节 发行条款

##### 一、本次发行基本情况

公司本次发行已经2020年6月19日召开的公司第五届董事会第十八次会议、2020年10月21日召开的公司第五届监事会第二十三次会议、2020年10月26日召开的公司第五届董事会第二十四次会议审议通过,并经公司2020年7月6日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。

本次发行经中国证监会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]3024号)核准。

- 2.证券类型:可转换公司债券。
- 3.发行规模:人民币244,000万元。
- 4.发行数量:2,440万张。
- 5.发行价格:本次可转换公司债券按面值发行。
- 6.募集资金总额及募集资金净额:本次发行可转换公司债券募集资金总额为244,000万元(含发行费用),含发行费用为2,639,000元,不含发行费用为49,848,113.21元,扣除合算的发行费用后,加上发行费用可抵扣增加增值税附加费,实际募集资金净额为2,390,151,886.70元。
- 7.募集资金用途:本次发行的募集资金总额不超过244,000万元(含),扣除发行费用后将全部用于以下项目:

序号	项目	项目投资总额(万元)	已投入金额(万元)	拟使用募集资金金额(万元)
1	晶圆测试及晶圆结构生产线项目(二)	118,919.98	25,068.70	130,000.00
2	CMOS图像传感器研发升级	136,413.94	—	80,000.00
3	补充流动资金	34,000.00	—	34,000.00
	合计	364,333.92	25,068.70	244,000.00

注:“已投入金额”为截至2020年9月30日项目已使用募集资金投资的金额。

##### 二、本次可转换公司债券发行条款

- (一)发行证券的种类
- 本次发行的证券种类为可转换为公司A股股票的可转债。该可转债及未来经可转债担保人承诺的A股股票将在上交所上市。
- (二)发行规模及发行数量
- 本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币244.00亿元,发行数量为244万手(2,440万张)。
- (三)票面金额和发行价格
- 本次发行的可转换公司债券面值为人民币100元。
- (四)债券期限
- 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年,即自2020年12月28日至2026年12月27日。
- (五)票面利率
- 本次发行的可转换公司债券利率设定为:第一年0.2%,第二年为0.4%,第三年为0.6%,第四年为1.5%,第五年为1.8%,第六年为2.0%。
- (六)还本付息的期限和方式
- 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。
- 1.年利息计算
- 年利息=可转债公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
- 2.年利息的计算公式为: $I=P \times i$
- 3.年利息利率
- 3.指本次发行的可转换公司债券持有人按在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息登记日持有的可转换公司债券票面总金额
- 4.指可转换公司债券当年票面利率
- 2.付息方式
- (一)发行证券的利率
- 本次发行的可转换公司债券利率为每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日,即2020年12月28日(“T日”)。
- (二)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)已转股或已申请转换为公司股票的未转股可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
- (三)付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
- (四)可转债持有人所获利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
- (七)转股期限
- 本次发行的可转换债券转股期自可转债发行结束之日起(2021年1月4日,即募集资金划至发行人账户之日起)满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止,即2021年7月5日至2026年12月27日止(如法定节假日或休息日顺延至其后的第一个工作日,顺延期间付息款项不另计息)。
- (八)转股价格的确定及其调整
- 1.初始转股价格的确定依据
- 本次发行的可转债的初始转股价格为222.83元/股,不低于募集说明书公告前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价。
- 前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量;前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
- 2.转股价格的调整方式和计算公式
- 在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加股本)、配股以及派发现金股利等情况,将按下述方式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):
- 派送红股或转增股本: $P1=P0 \div (1+n)$ ;
- 增发新股或配股: $P1=(P0+A \times K) / (1+k)$ ;
- 上述两项同时进行: $P1=(P0+A \times K) / (1+n+k)$ ;

发现金股利: $P1=P0-D$ ;

上述三项同时进行: $P1=(P0-D+A \times K) / (1+n+k)$ 。

其中:P1为调整后转股价格;P0为调整前转股价格;n为派送红股或转增股本率;A为增发新股或配股率;k为增发新股或配股率;D为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股本变动情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如有)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转股价格登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整前的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他使其公司股本结构、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

##### (九)转股价格的向下修正条款

1.修正条件与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的95%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价。同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前述三十个交易日日内发生过因除权、除息等引起可转债价格调整的情形,则在转股价格调整日前至交易日报调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

##### 2.修正程序

如公司决定向下修正转股价格时,公司将在上交所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)等。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

##### (十)转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

本次发行的可转换公司债券持有人在转股